### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-335472

(43) Date of publication of application: 07.12.1999

(51)Int.CI.

CO8J 5/18 B29B 11/16 B32B 27/00 B32B 27/20 CO8K 3/22 CO8K 3/28 CO8K 3/34 CO8L 83/04 H01F 1/00 H01F 1/34 H05K 9/00

(21)Application number: 11-068956

(71)Applicant:

FUJI KOBUNSHI KOGYO KK

(22) Date of filing:

15.03.1999

OKAYASU TAKAKO

(72)Inventor:

**FUJIMOTO MICHIHIRO** 

(30)Priority

Priority number: 10 74717

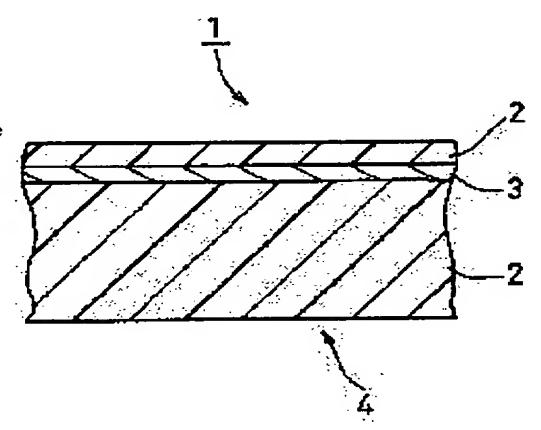
Priority date: 23.03.1998

Priority country: JP

### (54) ELECTROMAGNETIC WAVE-ABSORBING AND HEAT CONDUCTIVE SILICONE GEL-MOLDED SHEET AND PRODUCTION THEREOF (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an electromagnetic wave-absorbing and heat conductive silicone gel-molded sheet having a high electromagnetic wave-absorbing property and heat conductivity simultaneously.

SOLUTION: This silicone gel molded sheet is obtained by heating for molding a silicone gel composition containing metal oxide magnetic material particles and a heat conductive filler. The sheet shows a high electromagnetic wave absorption in 500-800 MHz frequency range. The hardness of the composition after curing is set as 10-95 range in the case of measuring by an ASKER F type hardness meter. As the metal oxide magnetic material particles, Mn-Zn ferrite or Ni-Zn ferrite having 1-50 μm mean particle diameter range, is used. Also, as the heat conductive filler, a metallic oxide, aluminum nitride, boron nitride, or silicone carbide is used. The silicone gel-molded sheet is formed by embedding an electroconductive mesh 3 in one side surface of the silicone gel layer and also by forming an adhesive surface 4 on the another surface thereof.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

11.04.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

2002-08358

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

10.05.2002

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-335472

(43)公開日 平成11年(1999)12月7日

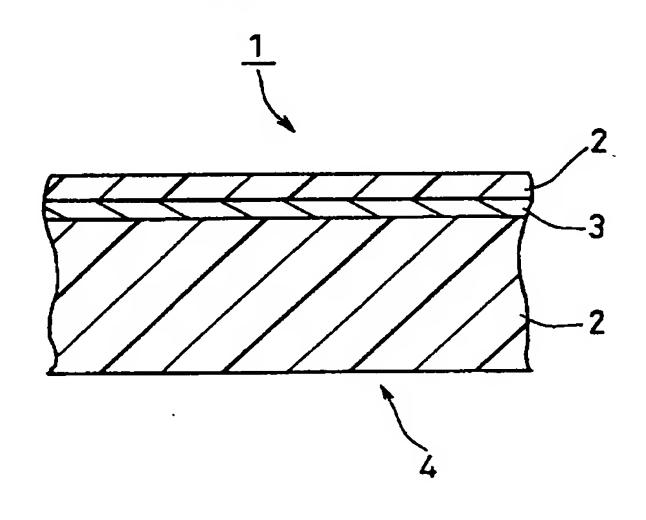
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	殿別記号		<b>F</b> Ι	
COSJ 5/18	CFH		C08J 5/18	CFH
`.	CFII		B 2 9 B 11/16	
B 2 9 B 11/16	4.0.4			1.0.1
B32B 27/00	101	•	B 3 2 B 27/00	1 0 1
27/20			27/20	Z
C 0 8 K 3/22			C08K $3/22$	
		審查請求	未請求 請求項の数14	I OL (全 7 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特願平11-68956</b>		(71)出顧人 00023	7422
			富士高	5分子工業株式会社
(22)出願日 平成11年(1999) 3月15日		愛知県	名古屋市中区千代田5丁目21番11号	
(as) hard H	1,7,422   (2000) 0 / 0 20		(72)発明者 岡安	
(31)優先権主張番号	特顏平10-74717		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	是西加茂郡小原村鍛冶屋敷175 富士
				子工業株式会社内
(32)優先日	平10(1998) 3月23日			
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72) 発明者 藤本	
				医加茂那小原村鍛冶屋敷175 富士
			高分子	了工業株式会社内
			(74)代理人 弁理士	上 池内 寛幸 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シートおよびその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 高い電磁波吸収性と熱伝導性とを併せ持つ低コストの電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シートを提供する。

【解決課題】 金属酸化物磁性体粒子と熱伝導性充填剤とを含むシリコーンゲルの組成物からシリコーンゲル成形シートを加熱形成する。このシートは、周波数500-80 CM-Izの範囲において高い電磁波吸収性を示す。前記組成物の硬化後の硬さは、ASKER F型硬度計で測定した場合、10-95の範囲に設定する。前記金属酸化物磁性体粒子としては、Mn-ZnフェライトまたはNi-Znフェライトであり、その平均粒子径は1-50μmの範囲のものを使用する。また、前記熱伝導性充填剤としては、金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素または炭化ケイ素を使用する。シリコーンゲル成形シート1はシリコーンゲル層2の一方の表層部分に導電性メッシュ3が埋設され、他方の面は粘着表面4が形成されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属酸化物磁性体粒子と熱伝導性充填剤 とを含むシリコーンゲル組成物から形成される電磁波吸 収性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

1

【請求項2】 シリコーンゲル成形シートの硬さが、A SKER F型硬度計で測定した場合、10~95の範 囲である請求項1に記載の電磁波吸収性熱伝導性シリコ ーンゲル成形シート。

【請求項3】 金属酸化物磁性体粒子が、Mn-Znフ ェライトおよびNi-Znフェライトから選ばれる少な 10 くとも一つの磁性材料である請求項1または2に記載の 電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

【請求項4】 金属酸化物磁性体粒子の平均粒子径が、 1~50μμの範囲である請求項1~3のいずれかに記 載の電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。 【請求項5】 熱伝導性充填剤が、金属酸化物、窒化ア ルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素および炭化ケイ素

からなる群から選択される少なくとも一種類の物質であ る請求項1~4のいずれかに記載の電磁波吸収性熱伝導 性シリコーンゲル成形シート。

【請求項6】 シリコーンゲル100重量部に対する金 属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤の合計含有量 が400重量部以上であり、前記金属酸化物磁性体粒子 (X)と熱伝導性充填剤(Y)との重量配合比がX:Y = 2:1~1:2の範囲である請求項1~5のいずれか に記載の電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シー **卜。** 

【請求項7】 シリコーンゲル成形シートの上下面の少 なくとも片面表層部に、さらにシート状の導電性補強材 を埋没させた請求項1~6のいずれかに記載の電磁波吸 30 電磁波を吸収するための技術が求められている。 収性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

【請求項8】 導電性補強材が、合成繊維、天然繊維お よび無機繊維から選ばれる少なくとも一つの繊維に導電 性金属を被覆した繊維を用いて形成した網目構造体であ る請求項7に記載の電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲ ル成形シート。

【請求項9】 シートの少なくとも一方の表面が、粘着 性を有する請求項1~8のいずれかに記載の電磁波吸収 性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

囲である請求項1~9のいずれかに記載の電磁波吸収性 熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

【請求項11】 厚み1mmのシートにおいて、10~ 1000MHzの範囲の周波数における電圧の減衰量が 10dB以上である請求項1~10のいずれかに記載の 電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形シート。

【請求項12】 請求項1~11に記載の電磁波吸収性 熱伝導性シリコーンゲル成形シートを製造する方法であ って、シリコーンゲルに金属酸化物磁性体粒子および熱

合物とし、前記混合物を脱泡機により脱気し、次いで脱 気後の前記混合物を所定の形状の支持フィルムで上下方 向に挟み、加熱しつつプレス成形により前記混合物を硬 化させてシートを作製することを特徴とする電磁波吸収 性熱伝導性シリコーンゲル成形シートの製造方法。

【請求項13】 脱気後のシリコーンゲル混合物を所定 の形状の支持フィルムで上下方向に挟み込む際に、所定 の形状の下側の支持フィルム上に硬化前の金属酸化物磁 性体粒子および熱伝導性充填剤を配合したシリコーンゲ ルを載せ、その上からシート状の導電性補強材と上側の 支持フィルムを被せた後、シート状の導電性補強材をシ リコーンゲル内に埋設する請求項12に記載の電磁波吸 収性熱伝導性シリコーンゲル成形シートの製造方法。

【請求項14】「シリコーンゲルは、付加反応型シリコ ーンゲルまたは縮合反応型シリコーンゲルである請求項 12または13に記載の電磁波吸収性熱伝導性シリコー ンゲル成形シートの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電磁波吸収性熱伝 導性シリコーンゲル成形シートに関する。 さらに詳しく は、例えば、発熱性電子部品等の電磁波ノイズの吸収と 放熱とを行うために用いられる電磁波吸収性熱伝導性シ リコーンゲル成形シートに関する。

### [0002]

【従来の技術】近年、急速に発達してきたコンピュータ ー、パソコン、テレビ等の電子機器は、多くの髙周波の 電磁波ノイズを発生するため、電磁波障害が問題になって ている。とのため、前記電子機器における電子部品等の

【0003】この問題に対して、種々の技術が提案され ・ており、例えば、金属磁性体粉末と樹脂との複合材を用 いて電磁波を吸収する技術(特開昭50-155999 号公報)が開示されている。しかし、このような電磁波 吸収材は、電磁波吸収力が弱く、電磁波を発生する電子 部品に装着した際に、十分な効果が得られないという問 題があった。

【0004】また、導電性材料の上に金属酸化物磁性体 粉末を充填した樹脂層を含む電磁波吸収性シート(特開 【請求項10】 シートの厚みが、0.2~5mmの範 40 昭57-129003号公報、特開平4-234103 号公報、特開平7-24988号公報)も開示されて いる。前記シートは、電磁波の一部を反射し、一部を吸 収してその電磁波を減衰させるという効果を示す。しか し、前記シートは、その構造が複雑であるため製造コス トが高く、また前記樹脂の耐熱強度が低いために、使用 可能温度範囲が狭いという問題があった。

【0005】他方、前記電子機器の発熱性電子部品等に ついて、放熱のために用いられる冷却構造の一部として **熱伝導性シートが提案されている(特開平2-1667** 伝導性充填剤を添加し、混合して均一組成物からなる混 50 55号公報、特開平2-196453号公報および特開

平6-155517号公報)。しかし、発熱性電子部品 は、同時に電磁波ノイズによる電磁波障害が問題になる ことが多く、このような場合には、熱伝導性シートの他 に、電磁波吸収を目的とするシールド材が併用されてい る。とのように二つ以上の部品が必要となることから、 コストが高くなるという問題があった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来の 問題を解決するため、高い電磁波吸収性と熱伝導性とを リコーンゲル成形シートを提供することを目的とする。 [0007]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明の電磁波吸収性熱伝導性シリコーンゲル成形 シートは、金属酸化物磁性体粒子と熱伝導性充填剤とを 含むシリコーンゲルから形成される。

【0008】このような本発明の前記シートは、金属酸 化物磁性体粒子と熱伝導性充填剤とを含有することによ り、従来の電磁波吸収性シートと放熱性シートとを併用 するよりも、高い電磁波吸収性と熱伝導性とを併せ持 つ。この理由は、次のように推察される。電磁エネルギ ーは、通常、電磁波吸収性シートに吸収されると熱エネ ルギーに変換され、本発明の前記シートでは、熱伝導性 を有するため、前記熱エネルギーが速やかに前記シート 内で伝達され、放熱される。このため、本発明の前記シ ートは、電磁エネルギーが直ちに熱エネルギーに変換さ れ、その結果、高い電磁波吸収性を発揮するのである。 したがって、本発明の前記シートは、電磁波吸収性と熱 伝導性の両性質を示すため単独で使用でき、その構造も 単純であり、また低コストであるため極めて有用であ る。また、前記シリコーンゲルは、その耐熱温度が他の 有機合成樹脂と比較して高く、耐熱性に優れているた め、本発明の前記シートは、広い温度範囲で使用すると とができる。

【0009】本発明の前記シートにおいては、シリコー ンゲル成形シートの上下面の少なくとも片面表層部に、 さらにシート状の導電性補強材を埋没させたことが好ま しい。これにより、さらに高い電磁波吸収性が得られ る。との理由は、本発明の前記シート内に侵入した電磁 ート内を再び通過する際に、前記した作用・効果、すな わち、電磁エネルギーは、通常、電磁波吸収性シートに 吸収されると熱エネルギーに変換され、本発明の前記シ ートでは、熱伝導性を有するため、前記熱エネルギーが 速やかに前記シート内で伝達され、放熱される。このた め、本発明の前記シートは、電磁エネルギーが直ちに熱 エネルギーに変換され、その結果、髙い電磁波吸収性を 発揮するという理由により再び効率良く熱エネルギーに 変換されるためである。また、本発明の電磁波吸収性熱

度も比較的弱いが、導電性補強材を埋没させるとによ り、補強材の役目を果たし、実装作業時の取り扱い性が 改善されるという利点もある。

【0010】次に本発明の電磁波吸収性熱伝導性シリコ ーンゲル成形シートの製造方法は、シリコーンゲルに金 属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤を添加し、混 合して均一組成物からなる混合物とし、前記混合物を脱 泡機により脱気し、次いで脱気後の前記混合物を所定の 形状の支持フィルムで上下方向に挟み、加熱しつつプレ 併せ持ち、また低コストである電磁波吸収性熱伝導性シ 10 ス成形により前記混合物を硬化させてシートを作製する ことを特徴とする。この方法により、前記本発明のシリ コーンゲル成型シートを効率良く合理的に製造できる。 【0011】前記方法においては、脱気後のシリコーン ゲル混合物を所定の形状の支持フィルムで上下方向に挟 み込む際に、所定の形状の下側の支持フィルム上に硬化 前の金属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤を配合 したシリコーンゲルを載せ、その上からシート状の導電 性補強材と上側の支持フィルムを被せた後、シート状の 導電性補強材をシリコーンゲル内に埋設することが好ま 20 しい。この方法により、前記導電性補強材を埋没させた シリコーンゲル成型シートを効率良く合理的に製造でき る。

### [0012]

【発明の実施の形態】本発明の成形シートにおいては、 厚み1mmのシートにおいて、10~1000MHzの 範囲の周波数における電圧の減衰量が10dB以上であ ることが好ましい。前記減衰量が10 d B以上であれ ば、電磁波吸収性能として実用的なレベルであるからで ある。また本発明の前記シートは、ASKER F型硬 30 度計で測定した場合の硬さが、10~95の範囲である ことが好ましく、特に好ましくは30~70の範囲であ る。前記硬さが10~95の範囲である本発明の前記シ ートは、発熱性電子部品と十分に密着することができ る。密着性が十分であれば前記シートの伝熱面積がさら に確保されるため、その放熱効率がより向上する。ま た、このように硬度を低く設定すれば、圧縮荷重を低く 抑えることも可能となる。なお、前記硬さとは、金属酸 化物磁性体粒子と熱伝導性充填剤とを含むシリコーンゲ ルをシート状に成形して硬化させた後の硬さをいう。ま 波が、導電性シートによって反射され、本発明の前記シ 40 た、本発明において、前記硬さは、次のようにして測定 する。

【0013】まず、前記シリコーンゲル成形シートまた はそのサンプルを準備し、シート面が水平となるように 配置する。そして、前記ASKER F型硬度計を手で 垂直に保持し、前記シートまたはサンプル表面と前記硬 度計の加圧面とがほぼ平行な状態で、前記シートまたは サンプル表面上に前記硬度計を静かに置き、手を離して そのまま放置する。その際に、前記硬度計の示す最大値 が、前記成形品の硬さである。前記硬度計は、その重量 伝導性シリコーンゲル成型シートは、低硬度であり、強 50 が約500gであり、その自重がそのまま測定圧となっ

て、硬度を測定するものである。なお、前記硬度を測定 する前記シートまたはサンブルは、そのシート面積が前 記加圧面の面積より大きく、厚みが25mmよりも厚け ればよく、例えば、縦100mm、横100mm、厚み 25mmの前記シートまたはサンプルであれば、測定に 供することができる。

【0014】本発明の前記シートにおいては、少なくと も一方の前記シート表面が、粘着性を有することが好ま しい。このように、前記シートの少なくとも片面が粘着 性を有することにより発熱性電子部品と十分に密着する 10 ことができるため、伝熱面積が充分に確保され、熱伝導 性および電磁波吸収性がさらに向上する。なお前記粘着 性は、加熱成形後のシリコーンゲル自体がもともと持っ ている性質である。

【0015】本発明の前記シートにおいては、金属酸化 物磁性体粒子が、Mn-ZnフェライトおよびNi-Z nフェライトから選ばれる少なくとも一つの磁性材料か ら形成されることが好ましい。この中でも特に好ましく はMn-2nフェライトである。また、前記金属酸化物 磁性体は、いずれか一種類とは限らず、二種類以上を併 20 用してもよい。

【0016】本発明の前記シートにおいては、金属酸化 物磁性体粒子の平均粒子径が1~50μmの範囲である ことが好ましく、特に好ましくは、1~20μmの範囲 である。ことで平均粒子径とは、重量平均粒子直径をい う。

【0017】本発明の前記シートにおいては、熱伝導性 充填剤が、金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ホウ 素、窒化ケイ素および炭化ケイ素からなる群から選択さ の中でも特に好ましくは、低コストの金属酸化物であ る。前記金属酸化物としては、例えば、酸化アルミニウ ム、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化チタン等が使用 でき、特に好ましくは、酸化アルミニウムである。ま た、前記熱伝導性充填剤は、いずれか一種類とは限ら ず、二種類以上を併用してもよい。

【0018】本発明の前記シートにおいては、シリコー ンゲル100重量部に対する金属酸化物磁性体粒子およ び熱伝導性充填剤の合計含有量が400重量部以上が好 ましく、より好ましくは400重量部以上600重量部 40 以下である。また、前記金属酸化物磁性体粒子(X)と 熱伝導性充填剤 (Y) との重量配合比がX: Y = 2:1 ~1:2の範囲であることが好ましく、特に好ましくは 前記重量配合比が1:1である。

【0019】前記において、シリコーンゲル成形シート の上下面の少なくとも片面表層部に、埋没させたシート 状の導電性補強材が、合成繊維、天然繊維および無機繊 維から選ばれる少なくとも一つの繊維に導電性金属を被 覆した繊維を用いて形成した網目構造体であることが好 ましい。導電性金属の被覆は、例えばメッキ、蒸着また 50

はスパッタリング等で形成できる。合成繊維としては、 ポリエステル繊維、耐熱ナイロン繊維、アラミド繊維、 ポリオレフィン繊維、ビニロン繊維等があり、天然繊維 としては、木綿、麻等がある。さらに無機繊維として は、炭素繊維またはガラス繊維等も使用できる。またメ ッキに用いられる導電体としては、銅、ニッケル、金、 銀、亜鉛、アルミニウム等の金属である。前記金属は一 種類とは限らず、2種類以上を併用しても良い。

【0020】次に、本発明の前記シートは、例えば、以 下のようにして作製できる。まず、シリコーンゲルに金 属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤を添加し、均 一になるまで撹拌して、この混合物を脱泡機により脱気 する。続いて、前記混合物を所定の形状の支持フィルム で上下方向に挟み、熱を加えるプレス成形により前記混 合物を硬化させることによって本発明の前記シートを作 製できる。

【0021】また、前記成型時において、所定の形状の 下側の支持フィルム上に硬化前の金属酸化物磁性体粒子 および熱伝導性充填剤を配合したシリコーンゲルを載 せ、その上からシート状の導電性補強材と上側の支持フ ィルムを被せた後、シート状の導電性補強材をシリコー ンゲル内に埋設し、シリコーンゲルを熱を加えるプレス 成形により硬化させて、電磁波吸収性熱伝導性シリコー ンゲルシートを作成できる。前記シリコーンゲルは、特 に制限されず、例えば、付加反応型シリコーンゲル、縮 合反応型シリコーンゲル等が使用でき、好ましくは付加 反応型シリコーンゲルである。

【0022】前記ブレス成形の温度条件は、前記混合物 の組成により適宜決定されるが、通常、前記混合物を硬 れる少なくとも一種類の物質であることが好ましい。こ 30 化できる温度であればよく、80~120℃の範囲であ る。また、前記プレス成形の圧力条件は、前記混合物の 組成により適宜決定されるが、通常30~150kgf /cm²の範囲であり、気泡の生起を防ぐため、好まし くは、50~80kgf/cm'の範囲である。前記プ レス成形の処理時間は、通常、前記混合物の組成、前記 温度条件および前記圧力条件により適宜決定されるが、 通常2~10分の範囲である。

> 【0023】前記支持フィルムとしては、例えば、樹脂 フィルム等が使用でき、好ましくはポリエチレンテレフ タレート (PET) フィルム、ポリプロピレン (PP) フィルム、ポリエチレン(PE)フィルム等であり、特 に好ましくはPETフィルムである。 前記支持フィルム は、通常、前記プレス成形後に除去する。

【0024】前記支持フィルムの厚みは、25~250  $\mu$ mの範囲が好ましく、特に好ましくは $50\sim150$   $\mu$ mの範囲である。

【0025】また、本発明の前記シートの成形方法とし ては、前記プレス成形の他にも、例えば、コーティング 成形、カレンダー成形、圧延成形等が適用できる。

【0026】本発明の前記シートの厚みは、0.2~5

mmの範囲が好ましく、特に好ましくは $0.5 \sim 3 mm$ の範囲である。

【0027】本発明の前記シートは、前記金属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤の他に、その他の成分を含んでいてもよく、例えば、粘着剤、補強剤、着色剤、耐熱向上剤、接着助剤等を含有していてもよい。その割合は、本発明の前記シートの特性に支障をきたさない範囲であれば特に制限されない。

### [0028]

### 【0029】(1)比重

JIS K 7112に準じて、水中置換法により比重の測定を行った。0.5~5gfのサンプルを直径0.1mm以下の金属線で結び、23℃の空気中で正確に秤量し、これを23℃に設定された蒸留水の入ったビーカーに入れ、水中における質量を測定し、下記式(数1)により比重(S)を求めた。下記式において、aは前記 20サンプルの空気中の質量、bは前記サンプルの水中の質量をそれぞれ示す。

#### 【数1】S=a/(a-b)

【0030】(2)硬度

各実施例および比較例と同じ組成のシートを同様の方法で作製したテストサンブルシート(100×100×25mm)について、ASKER F型硬度計(高分子計器(株)社製)を使用し、前述と同様の方法により硬さを測定した。

### 【0031】(3)電気体積抵抗率

JIS C 2123 に準じて、電気体積抵抗率 (単位: Ω·cm) の測定を行った。

### 【0032】(4)熱抵抗

トタンジスタ(TO-3型)とヒートシンクとの間に実施例等で調製したサンプルを挟み、これらに2kgの荷重をかけ、トランジスタに20wの電力を印加する。そして、所定位置に取り付けた温度センサーにより、 $3分後のトランジスタ温度(TC、単位: <math>^{\circ}$ C)と放熱器温度(TF、単位:  $^{\circ}$ C)とをそれぞれ測定し、下記式(数2)により、熱抵抗( $\theta$ 、単位:  $^{\circ}$ C/w)を求めた。
[数2]  $\theta = (TC-TF)/20$ 

#### 【0033】(5)伝導ノイズ

実施例等で調製したサンブルをCPU(中央処理ユニット)と放熱板との間に組み込み、端子伝導ノイズ測定法により測定を行った。前記CPUから発信された信号系の特定周波数における電圧をスペアナーで読み取り、前記電圧の変動を調べた。

### [0034](6)電磁波吸収性

MIL-STDは米国の国際規格の ミリタリー スタンダード(Militaly Standard)を示 し、MIL-STD-285はシールデッド ルーム テストメソッド(Shielded Room Test Method)を示す)に準じて電磁波吸収性(単位:dB)の測定を行った。測定は、テクトロニクス(Tektronix) 社製 492スペクトロムアナライザーを用い、10 MHz~100 MHzの範囲で行った。

8

### 【0035】(7)電磁波シールド性

社団法人、関西電子工業振興センター製電磁波シールド性評価器を用いて、10MHz~100MHzの範囲で添過減衰量を測定した

【0036】(実施例1)シリコーンゲル100重量 部、金属酸化物磁性体粒子250重量部および熱伝導性 充填剤250重量部を攪拌機を用いて均一になるまで混 合撹拌した。前記シリコーンゲルとしては、付加反応型 シリコーンゲル (東芝シリコーン(株)社製、以下同 じ)を、前記金属酸化物磁性体粒子としては、重量平均 粒子直径が3μmであるMn-Znフェライト(戸田工 業(株)社製、以下同じ)を、熱伝導性充填剤として は、重量平均粒子直径が37μmである球状アルミナ (昭和電工(株)社製、以下同じ)をそれぞれ使用し た。前記組成物を脱泡機を用いて気泡を除去した後、と れを厚さ100μmのPETフィルムで挟み、80kgf/ om の圧力をかけ、120℃で5分間加熱して、プレス 成形を行った。その結果、厚み1mmのシリコーンゲル 成形シートが得られた。前記シートの電磁波吸収性の測 定結果を下記の表 1 に示す。また諸特性についての測定 結果を後の表2に示す。また、図1のグラフの実線に、 前記シートの伝導ノイズの評価である周波数と電圧との 関係を示す。

### 30 [0037]

### 【表1】

	10MHz	~	1000MHz
実施例1	-20dB		-20dB

【0038】前記表1のとおり、本発明の実施例1は10MHz~1000MHzの範囲で-20dB一定であった。これに対して従来技術の各特許公報に記載されている電磁波吸収性は10MHz~1000MHzの範囲 で-10dB程度であった。

【0039】(実施例2)実施例1と同様の、硬化前の金属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤を配合したシリコーンゲル組成物を、脱泡機を用いて気泡を除去した後、PETフィルム上に載せ、その上からボリエステル繊維(太さ約10μm)に、ニッケルを無電解メッキにより厚さ約0.2μm被覆した繊維を用いて、網目状構造体(ネット、目付:24.3g/m²、厚み:0.25mm)としたセーレン社製の導電性メッシュ(商品名"ブラットSE200")を載せ、その上から厚さ100μmのPE
50 Tフィルムを被せ、120℃で5分間加熱して、プレス

成形を行った。その結果、厚み1mmのシリコーンゲル 成形シートが得られた。前記シートの電磁波吸収性の測 定結果を下記の表2に示す。また諸特性についての測定 結果を後の表3に示す。また、図2のグラフの実線に、 前記シートの電磁波シールド性の評価結果を示す。前記 電磁波シールド性は、周波数と透過減衰量との関係で示 す。このグラフの破線は、導電性補強材のみの測定結果 である。図3は実施例2で得られたシリコーンゲル成形 シート1の概略断面図である。シリコーンゲル層2の一 方の表層部分に導電性メッシュ3が埋設され、他方の面 10 は加熱成形後のシリコーンゲル自体が有する性質の強粘\*

\*着表面4が形成されている。

【0040】(比較例1)シリコーンゲル100重量部 とMn-Znフェライト550重量部とを混合し、この 混合物を用いて、以後実施例1と同様にして、厚み1m mのシリコーンゲル成形シートを作製した。前記シート の諸特性についての測定結果を下記表2に示す。また、 図1のグラフの破線に、前記シートの伝導ノイズの評価 である周波数と電圧との関係を示す。

10

[0041]

【表2】

	実施例1	実施例2	比較例1
比重	2. 7	2. 7	3. 0
硬さ(ASKER F型硬度計)	. 5 6	5 6	4 8
電気体積抵抗率(x10 <sup>13</sup> Ω·cm)	0. 1	0. 1	1. 2
熱抵抗(℃/w)	1. 3	1. 3	1. 7

【0042】以上の実施例および比較例から明らかなと 20 い電磁波吸収性が得られる。 おり、前記表2に示すように、金属酸化物磁性体粒子の みを含有する比較例 1 のシートに比べて、本発明の実施 例のシートは、その熱抵抗が低かった。このことから、 実施例では、比較例よりも熱伝導性が高いシリコーンゲ ル成形シートが得られたといえる。また、図1に示すよ うに、実施例1のシートの伝導ノイズは、比較例1と比 べて周波数500~800MHzの範囲において、明ら かな差が見られ、電磁波吸収性に優れていた。また、表 2に示すように、実施例1のシートは、周波数10MH が確認された。さらに図2に示すように、実施例2のシ ートの電磁波シールド性は、従来技術に比較してはるか に高いことが確認できた。

### [0043]

【発明の効果】以上のように、本発明の前記シートは、 高い電磁波吸収性と熱伝導性とを併せ持つ。このため、 本発明の前記シートを電子部品等へ使用すれば十分な電 磁波吸収および放熱の効果を得ることができる。また、 本発明の前記シートは、構造も単純であることからコス トも低く、電子部品への装着もより容易に行うことが可 40 イズの測定を行った結果を表すグラフである。 能であり、利用に適したものである。また、本発明の前 記シートは、その硬度を低く設定すれば圧縮荷重値を低 く抑えることが可能となるため、これにより放熱性電子 部品、放熱体、基盤等を含む実装挟体の圧縮による変 形、損傷等を防止し、電子部品等の信頼性を向上すると とができる。

【0044】また、シリコーンゲル成形シートの上下面 の少なくとも片面表層部に、さらにシート状の導電性補 強材を埋没させたという好ましい例によれば、さらに髙

【0045】次に本発明の製造方法は、シリコーンゲル に金属酸化物磁性体粒子および熱伝導性充填剤を添加 し、混合して均一組成物からなる混合物とし、前記混合 物を脱泡機により脱気し、次いで脱気後の前記混合物を 所定の形状の支持フィルムで上下方向に挟み、加熱しつ つプレス成形により前記混合物を硬化させてシートを作 製することにより、前記本発明のシリコーンゲル成型シ ートを効率良く合理的に製造できる。

【0046】また、脱気後のシリコーンゲル混合物を所 2~1000MHzの範囲において、高い電磁波吸収性 30 定の形状の支持フィルムで上下方向に挟み込む際に、所 定の形状の下側の支持フィルム上に硬化前の金属酸化物 磁性体粒子および熱伝導性充填剤を配合したシリコーン ゲルを載せ、その上からシート状の導電性補強材と上側 の支持フィルムを被せた後、シート状の導電性補強材を シリコーンゲル内に埋設するという好ましい例によれ ば、前記導電性補強材を埋没させたシリコーンゲル成型 シートを効率良く合理的に製造できる。

#### 【図面の簡単な説明】

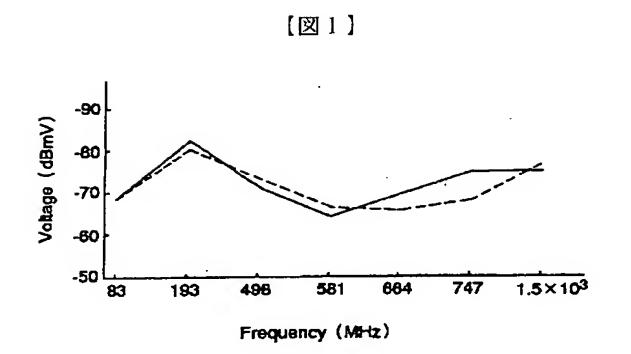
【図1】 本発明の実施例1のシートについて、伝導ノ

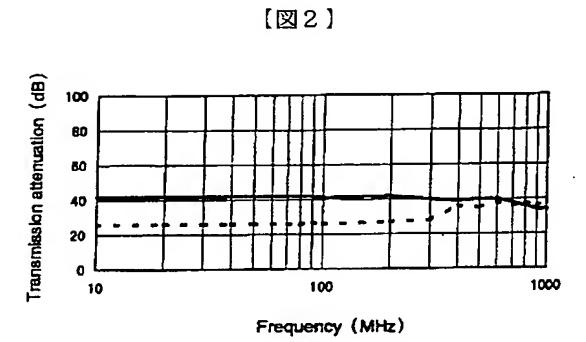
【図2】 本発明の実施例2のシートについて、電磁波 シールド性の測定を行った結果を表すグラフである。

【図3】 本発明の実施例2で得られたシートの概略断 面図。

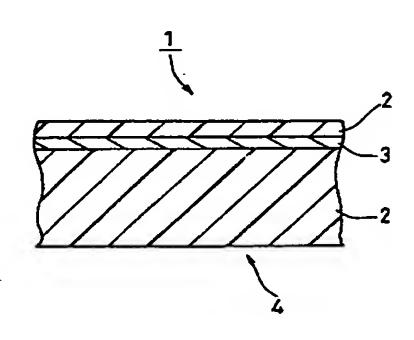
### 【符号の説明】

- 1 シリコーンゲル成形シート
- 2 シリコーンゲル層
- 3 導電性メッシュ
- 4 粘着表面





【図3】



## フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FI		
C 0 8 K	3/28		C 0 8 K	3/28	
	3/34			3/34	
C 0 8 L	83/04		C 0 8 L	83/04	
HOlF	1/00		H 0 5 K	9/00	М
	1/34		H01F	1/00	С
H 0 5 K	9/00	•		1/34	В
					Α